

第 9 回

応用物理学実験

題目	熱測定で見る相転移
----	-----------

氏 名 : 西原 翔

学 籍 番 号 : 1522068

学部学科学年 : 理学部第一部応用物理学科3年

共同実験者:1522064 中井空弥
1522091 宮田崇杜
1522095 村山涼矢
1522B02 中村洸太

提出年月日:2024 年 11 月 21 日
実験実施日:2024 年 11 月 08 日
2024 年 11 月 15 日

東京理科大学理学部第1部
応用物理学教室

Abstract

1 原理

1.1 示差熱分析と示差走査熱量測定

試料の熱的性質を側する熱測定には、示差熱分析 (DTA), 示差走査熱量測定 (DSC) という手法があり、DSC には入力補償型 DSC と熱流束型 DSC の 2 種類がある。これら 3 つの測定方法は共通点が多く得られるデータも似たようなものであるが、その仕組みは異なっている。

DTA は、調べたいサンプル試料とよく性質のわかっている参照用試料の両方を同じ熱源で温め、これら 2 つの物質の中に入れた温度計 (熱電対) の温度差を測定する手法である。サンプル物質で相転移が起こり熱異常が発生すると、転移熱によって 2 つの物質の温度差が生じることから熱異常を測定する方法である。温度をそのまま見ることから相転移温度を確認するには便利であるが、潜熱を求めるには工夫が必要がある。

入力補償型 DSC は、サンプル試料と参照用試料の温度が等しくなるように熱を加えていく方法である。サンプル試料に熱異常が起こると試料に加える熱を増やす必要があるためこの入力する熱量の差によって潜熱を測定することになる。この測定では直接熱量が得られるため潜熱といった熱力学量を調べることが簡単である。しかし、熱源と試料全体の間には熱抵抗があるため試料に加える熱量は実際の試料全体の温度ではなく、ヒーターの傍にある局所的な温度を見て決めることになるため転移温度を読むには注意が必要である。

熱流束型 DSC は、DTA と同様に 2 つの試料に同じ熱量を与えたときの温度差を測定するものである。ただ、DTA では直接試料に温度を取り付け温めていたのに対し、熱流束型 DSC では測定セルに試料を入れ、測定セルの温度を測定するという違いがある。これにより気液相転移といった相転移であっても測定ができる一方、試料とセルの間、セルとヒーターの間に熱抵抗が生じるため、転移温度を読むには適していない。

1.2 Mraw のモデル

DTA と DSC の動作原理として Mraw のモデル [1] がある (図 1)。これは DTA と DSC の測定装置をヒーターの温度、温度計を取り付けることとなる試料側面、試料のバルク部分に分け、それぞれの間の熱流に関して微分方程式で説明するモデルである。

図 1 右側にある参照用の試料での熱の流れは

$$\frac{dq_r}{dt} = C_{rm} \frac{dT_{rm}}{dt} + C_r \frac{dT_r}{dt}, \quad \frac{dq'_r}{dt} = C_r \frac{dT_r}{dt} \quad (1)$$

というように表される。ここでの $\frac{dq_r}{dt}$ はヒーターから表面への熱流、 C_{rm}, C_r はそれぞれ表面部分とバルク部分の熱容量、 T_{rm}, T_r はそれぞれ表面部分とバルク部分の温度を表している。

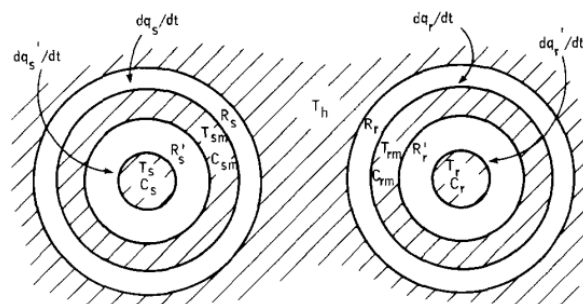


図 1: Mraw のモデル [1]. 左がサンプル試料、右側が参照用の試料の温度と熱抵抗の模式図になっている。

一次相転移を起こさないときには左側にあるサンプル試料でも同様の式

$$\frac{dq_s}{dt} = C_{sm} \frac{dT_{sm}}{dt} + C_r \frac{dT_s}{dt}, \quad \frac{dq'_s}{dt} = C_s \frac{dT_s}{dt} \quad (2)$$

で表される。次に一次相転移が生じるときのことを考える。試料表面ではその体積が小さくすぐに相転移が終わる。バルク部分では一次相転移の潜熱のため温度は一定であり、即座に潜熱分の熱が流入するわけではないので、試料は転移が済んだ部分と済んでいない部分に分かれる。これを微分方程式のモデルにすると、

$$\frac{dq_s}{dt} = C_{sm} \frac{dT_{sm}}{dt} + \Delta H \frac{d\alpha}{dt}, \quad \frac{dq'_s}{dt} = \Delta H \frac{d\alpha}{dt} \quad (3)$$

というように表せる。ここでの ΔH は転移エンタルピー、 α は試料中の転移が済んだ割合を表す。

熱流 $\frac{dq}{dt}$ は温度勾配に比例するというニュートンの冷却則

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{R_r} (T_h - T_{rm}) \quad (4)$$

を用いて温度としてあらわすことができるのでこれらの微分方程式を連立することで解くことができるのがわかる。

このモデルを DTA およこのモデルを DTA および DSC にどのように適用されるか見ていく。古典的 DTA では試料表面で温度を測定するのではなく、内部の温度を測定する。そのため始め表面部分と内部で分けていたが一体になったものとみなすことができ、これらの間には熱抵抗は無く、 $T_{sm} = T_s$, $T_{rm} = T_r$ である。そしてヒーターの温度は一定速度 $T_h = at + T_{h0}$ で変化するものとみなす。この条件で微分方程式を解くとその振る舞いが得られる。入力補償 DSC ではサンプル試料と参照用試料の表面での温度が同じになるように熱流を調整する。そのため、ヒーター部分と表面部分が一体になったものとみなすことができる。すると古典的 DTA と同じ式の形となるため入力補償 DSC で得られる温度のデータは古典的 DTA と同じような振る舞いとなる。

今回行う 熱流束 DSC ではそういった Mraw モデルのパラメータすべてを使うことになる。このときヒーターと試料表面との間の熱抵抗は同じになるように装置は作ってある。この熱抵抗を $R = R_s = R_r$ とおく。これを解析すると図 2 のようになる [2]。この図の縦軸に熱抵抗 R を掛けることで熱流 \dot{H} となるため、これに温度を割ったものがエントロピー流 \dot{S} 、図 2 の盛り上がった部分の面積が転移エンタルピー ΔH 、転移エントロピー ΔS となる。また比熱は

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \frac{dt}{dT} \frac{dH}{dt} = \frac{\dot{H}}{\dot{T}} \quad (5)$$

で求めることができる。

また、各手法とこの Mraw のモデルを考えると DTA と DSC は同じ測定原理・同じようなシグナルが出るという説明のされ方は不十分であるというのがわかる。より正確には DTA と熱流束型 DSC は温度差を見るという点では同じ測定原理であるが、シグナルは微分方程式モデルが異なることから違った形が出る、DTA と入力補償型 DSC は測定原理は違うが、モデルは同じ形になるためシグナルは同じになると説明されるべきである。

2 実験

熱流型 DSC 測定機器である (株) 日立ハイテクサイエンス DSC7020 を用いて、In の固液相転移、Ni の磁気相転移、BTO の変異型強誘電相転移、TGS の秩序・無秩序型強誘電相転移に伴う熱異常を測定した。

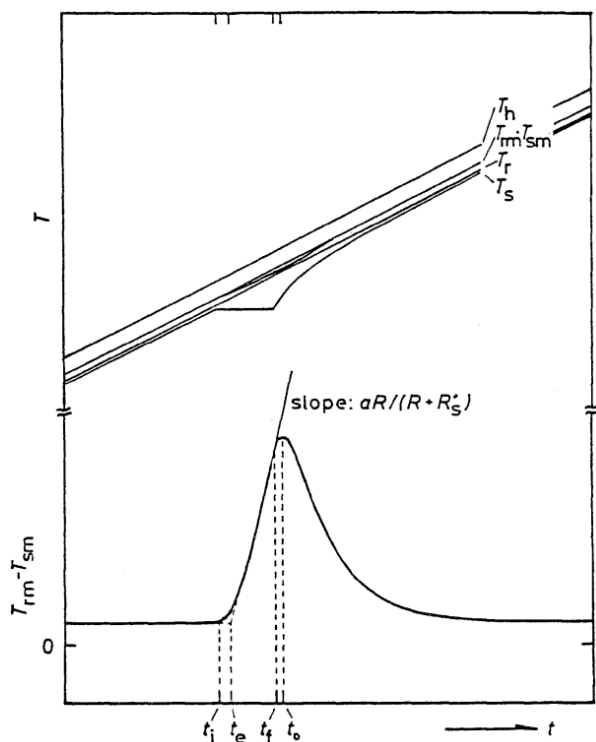


図 2: Mraw のモデルを使った一次相転移時の熱流束 DSC の振る舞い [2].

3 結果

3.1 数値微分

比熱を計算する際に離散的なデータから微分を行う必要が生じる。関数 $f(x)$ を微分する際に、微分を差分で近似する方法である

$$f'[i] = \frac{f[i+1] - f[i]}{x[i+1] - x[i]} \quad (6)$$

では分母の誤差が大きくなってしまいうため、実際の微分とは大きくずれてしまうことが多い。これを抑えるため、Savitzky-Golay フィルターを使った微分

$$f'[i] = \frac{86f[i-4] - 142f[i-3] - 193f[i-2] - 126f[i-1] + 126f[i+1] + 193f[i+2] + 142f[i+3] - 86f[i+4]}{1188(x[i+1] - x[i])} \quad (7)$$

を使った。また測定点が多いためこのフィルターを改良することができる。連続するデータでは誤差に相関が生じるが、離れば離れるほど相関はなくなるため差分は離れた測定点同士で行うと誤差の影響が小さくなるので微分を

$$f'[i] = \frac{86f[i-40] - 142f[i-30] - 193f[i-20] - 126f[i-10] + 126f[i+10] + 193f[i+20] + 142f[i+30] - 86f[i+40]}{1188(x[i+10] - x[i])} \quad (8)$$

というようにして計算をする。

3.2 In の固相液相転移

In の固相液相転移付近における熱流 \dot{H} 、エントロピー流 \dot{S} 、および比熱 C_p は以下ようになった。

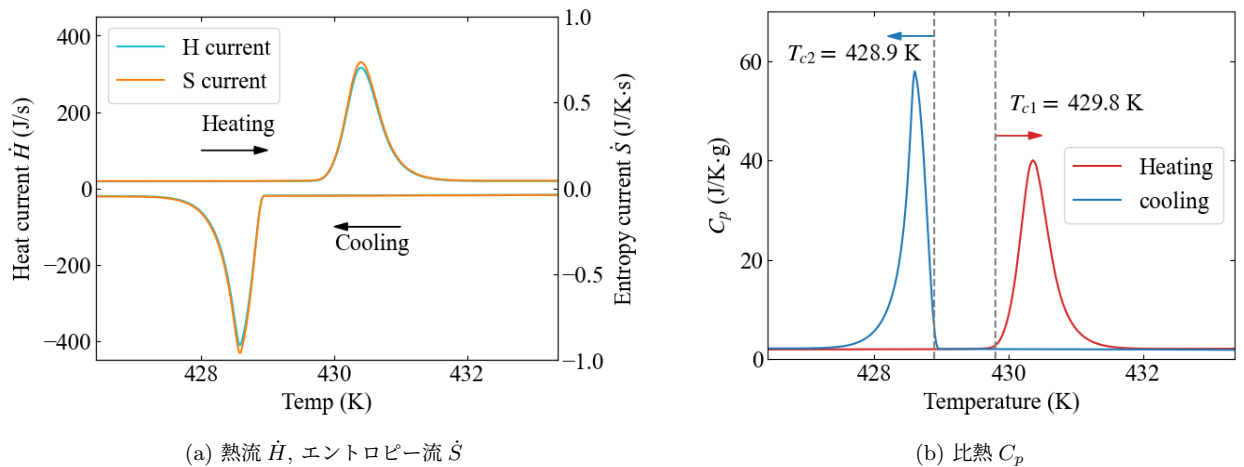


図 3: 相転移付近における In の熱的性質

3.3 Ni の磁気相転移

Ni の磁気相転移付近における熱流 \dot{H} 、エントロピー流 \dot{S} 、および比熱 C_p は以下ようになった。

3.4 BTO の変異型強誘電相転移

BTO の変異型強誘電相転移付近における熱流 \dot{H} 、エントロピー流 \dot{S} 、および比熱 C_p は以下ようになった。

3.5 TGS の秩序・無秩序型強誘電相転移

TGS の秩序・無秩序型強誘電相転移付近における熱流 \dot{H} 、エントロピー流 \dot{S} 、および比熱 C_p は以下ようになった。

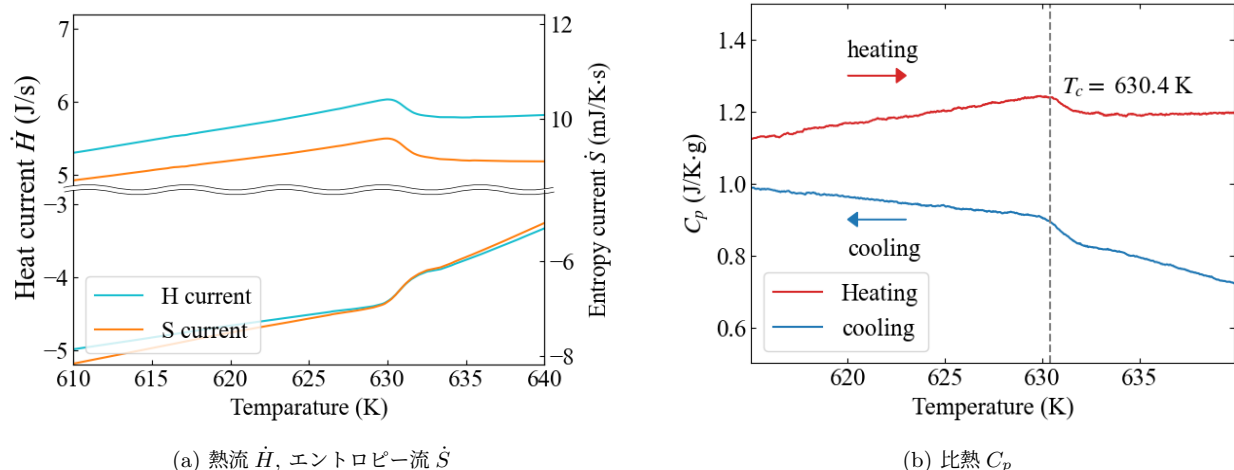


図 4: 相転移付近における Ni の熱的性質

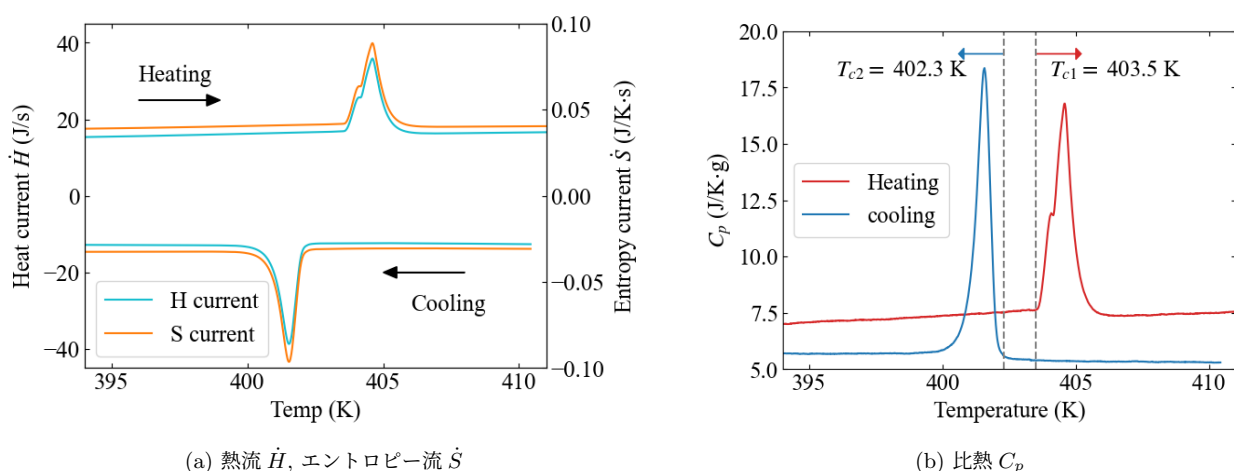


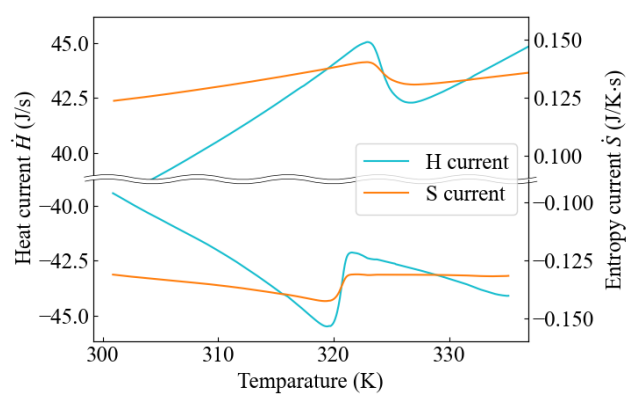
図 5: 相転移付近における BTO の熱的性質

4 考察

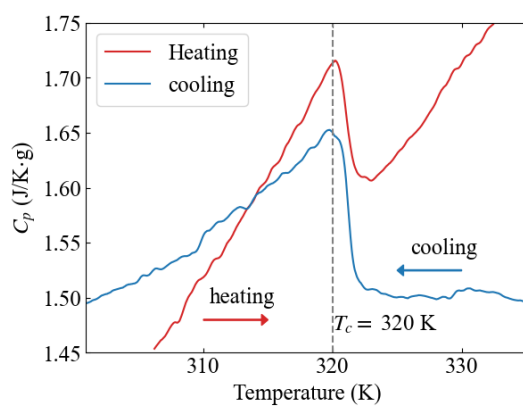
5 結論

参考文献

- [1] Stephen C. Mraw. Mathematical treatment of heat flow in differential scanning calorimetry and differential thermal analysis instruments. *Rev. Sci. Instrum.*, Vol. 53, pp. 228–231, 1982.
- [2] 齋藤一弥, 阿竹徹, 齋藤安俊. 古典的 DTA, 入力補償 DSC および熱流束 DSC の理論的考察. 熱測定, Vol. 14, No. 1, pp. 2–11, 1987.
- [3] 齋藤安俊. 示差熱分析および示差走査熱量測定の基本原理と問題点. 無機マテリアル, Vol. 3, No. 263, pp. 271–283, 1996.



(a) 熱流 \dot{H} , エントロピー流 \dot{S}



(b) 比熱 C_p

図 6: 相転移付近における TGS の熱的性質